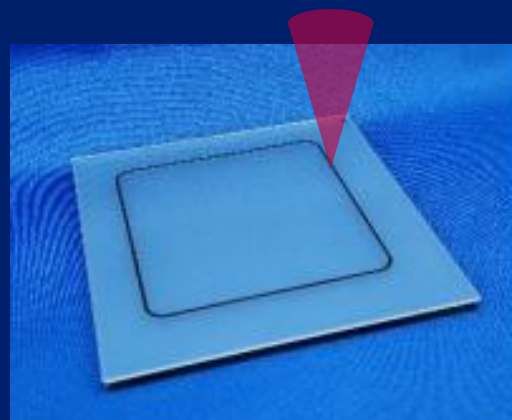


AGC局部加热用途密封 浆料介绍

电子公司 电子材料事业本部
先进材料事业部
半导体材料统括部 玻璃料部

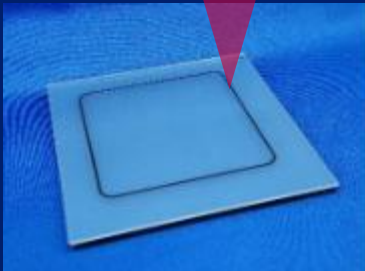
AGC株式会社



AGC

Your Dreams, Our Challenge

产品特点



1

密封时不会对元件造成热损伤

通过局部加热，可在不对已封装元件**造成热损伤的情况下**进行封装

2

可形成高气密性与高可靠性

可形成高气密性和耐湿性，能够**长时间**为耐湿性较差的元件提供**可靠保护**。

3

元件尺寸适用范围广

较大的密封余量和丰富的产品阵容，可适用于各种不同尺寸元件

4

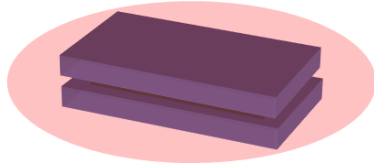
可进行低温预烧

可根据客户所需形态，提供多种产品，欢迎随时垂询。

激光加热气密封装的特点

传统技术

Furnace Sealing

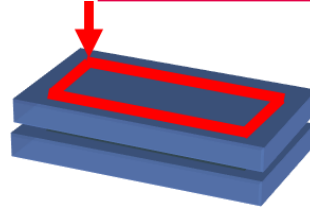


包括密封材料在内，在400°C~500°C条件下对整个电路板进行加热

无法封装低耐热性元件

Our Proposals

Laser Sealing



仅对密封材料进行局部加热

内部可在室温下封装!

Point!

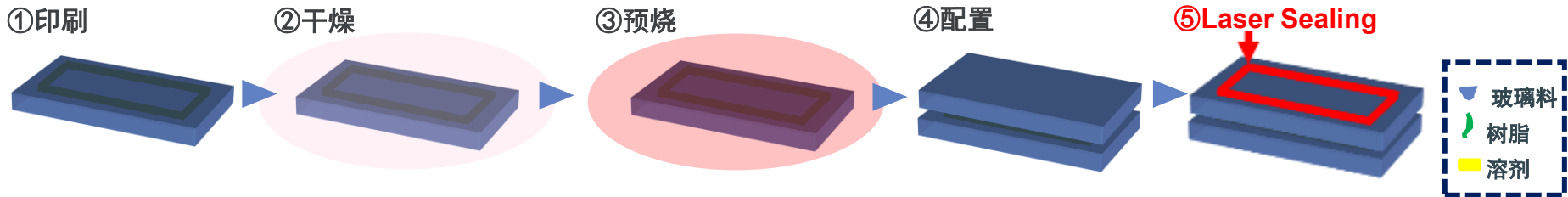
- 可在不对内部**造成热损伤的情况下**进行密封。
- 可形成高气密性与高可靠性。

Point!

	树脂密封	玻璃密封
透水性 g/m ² /day	<10 ⁻¹	<10 ⁻⁵
耐候性 60°C×90%RH	1000hr	10000hr<

玻璃密封保护对象	应用示例
有机EL元件	OLED
钙钛矿结构	Perovskite solar cell Q-LED

激光密封工艺



工艺	目的	装置	示意图 (截面)
①印刷	在电路板上印刷玻璃浆料，形成所需图案	丝网印刷机或点胶机	
②干燥	去除溶剂	烘干机 (120°C~180°C)	
③预烧	去除电路板上的树脂并进行玻璃烧结	烧成炉 (350°C~500°C)	
④配置	将已完成预烧的电路板置于含不耐热元件的电路板上	-	
⑤激光密封	通过激光照射使玻璃熔化，实现电路板之间的粘合	激光装置	

END

我们将竭尽全力，助客户实现梦想

日本国东京都千代田区丸之内一丁目5番1号
新丸之内大厦

AGC

Your Dreams, Our Challenge